

REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2016.11.28

技术要求:

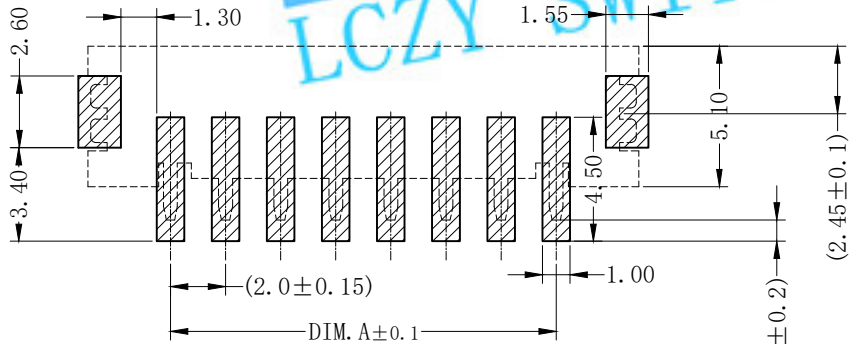
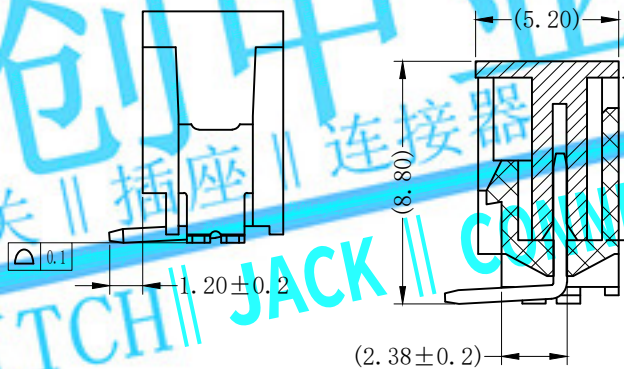
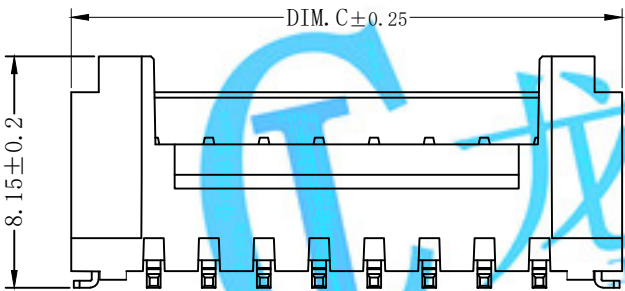
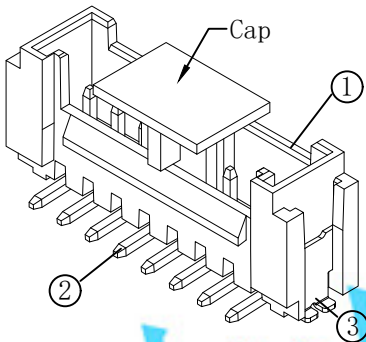
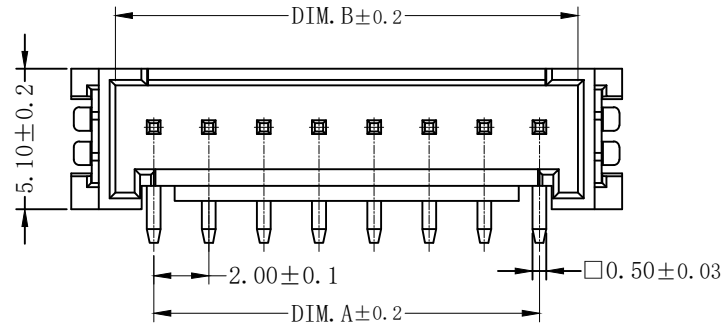
- 1、塑件材料: LCP (UL-94V-0)
- 2、接触件: 黄铜镀锡
- 3、接触电阻: $\leq 10\text{m}\Omega$
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
- 5、额定电压: 250V AC DC
- 6、额定电流: 2.0A AC DC
- 7、耐压: 能承受1000V AC/Minute
- 8、工作温度: $-25^{\circ}\sim +105^{\circ}$
- 9、可焊性试验: 浸锡面积 $\geq 95\%$ 温度 260^{+5}_{-0}a , 时间 2.5 ± 0.5 秒
- 10、铅和镉等六大有害物质含量要符合环保要求

HY-2.0-XP-LT-DK

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.00	4.80	8.00
03	4.00	6.80	10.00
04	6.00	8.80	12.00
05	8.00	10.80	14.00
06	10.00	12.80	16.00
07	12.00	14.80	18.00
08	14.00	16.80	20.00
09	16.00	18.80	22.00
10	18.00	20.80	24.00
11	20.00	22.80	26.00
12	22.00	24.80	28.00
13	24.00	26.80	30.00
...	...	...	...
20	38.00	40.80	44.00

3	焊片 Fitting Nail	黄铜 Brass	2	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u"MIN.
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底锡30u"MIN, 再镀锡80u"MIN.
1	基座 Wafer	LCP (UL94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY		龙创中业电子科技(东莞) 有限公司	
0.X	± 0.25	$X.^{\circ} \pm 3^{\circ}$	CHK. BY			
0.XX	± 0.12		APRV. BY		SHEET	PROD. NAME
0.XXX	± 0.05	$X.X^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	DRAWING NO.		1 OF 1	PART NO. HY-2.0-XP-LT-DK
UNIT	SIZE	SCALE	006-0082-001		TITLE	
MM	A4	1:1			2.00 FPC CONN. ZIF SMT FRONTFLIP H=2.0 DOUBLE LOWER CONTACT	



SUGGESTED PCB LAYOUT
(COMPONENT SIDE)

借用登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期